

GMM

Stone Shih, President

Place: Hyatt

November 23th, 2021

- 2021 Q3 營運成果
- 市場趨勢與產品發展

GMM

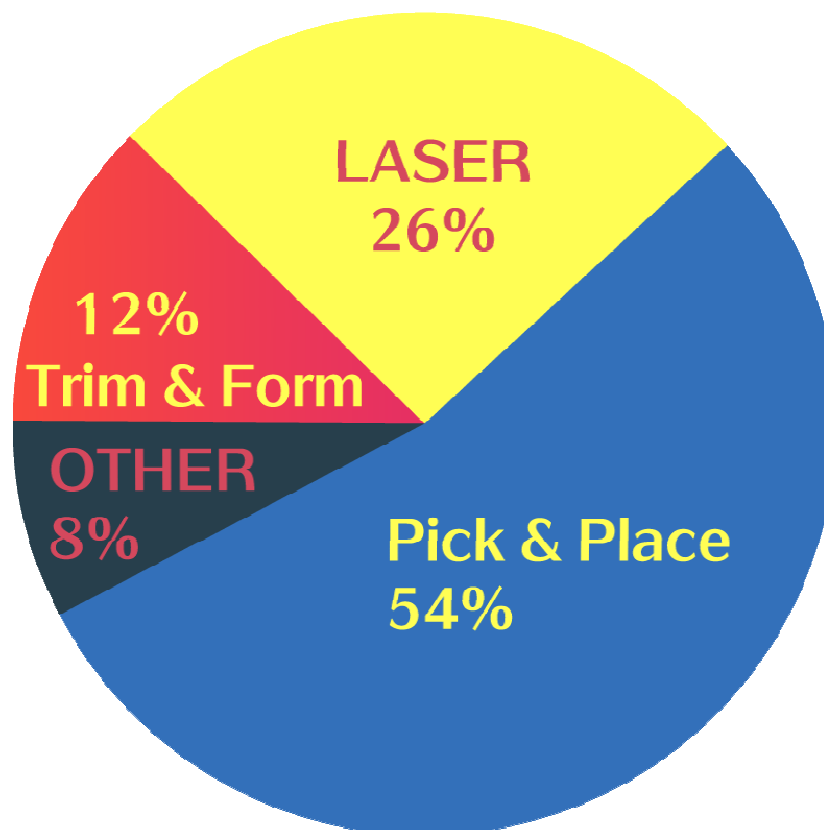
2021 Q3

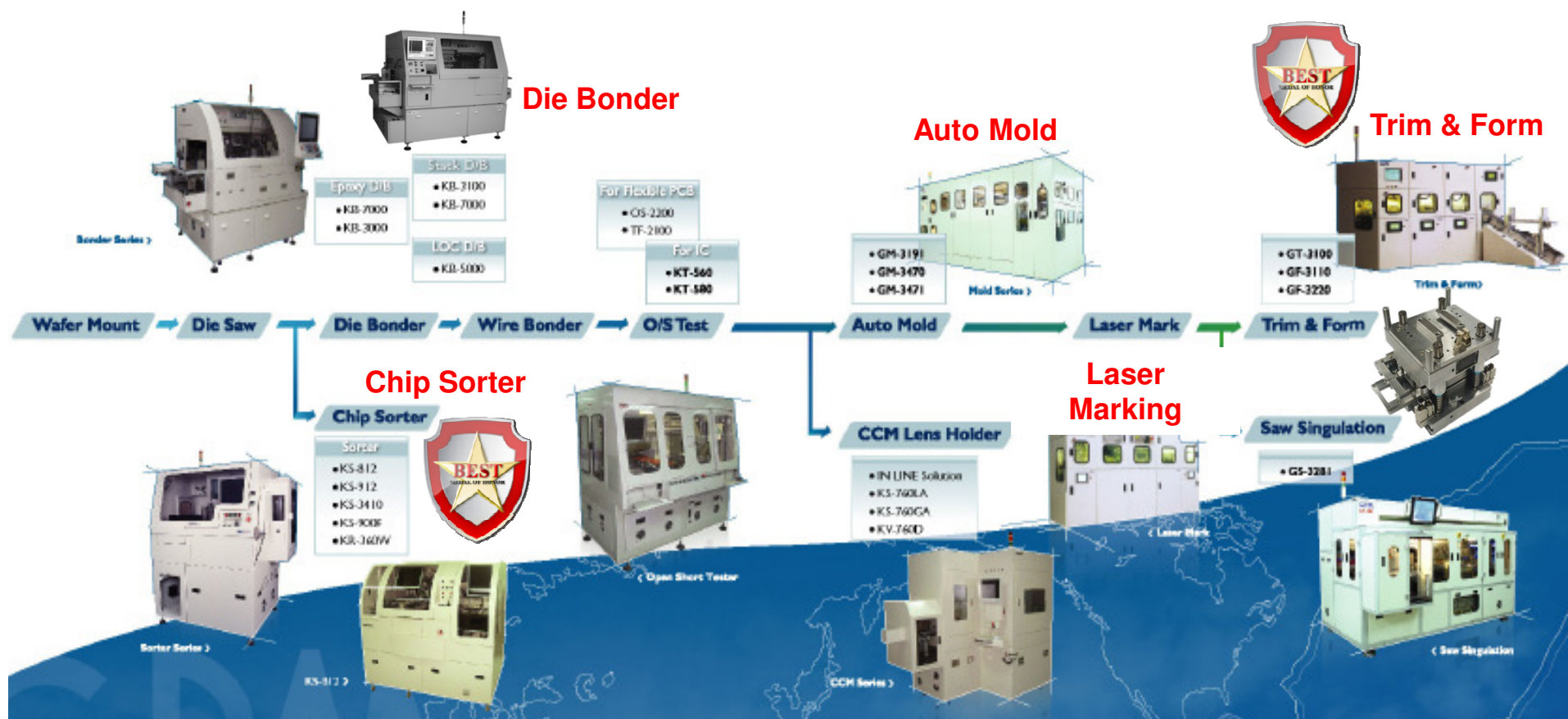
營運成果

in TWD 千元

	2021Q3 累計		2020		2019		2018	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
Revenue-Consolidated	1,091,464		877,331		758,006		922,261	
COGS	713,432	65.4%	616,404	70.3%	477,057	62.9%	607,763	65.9%
Gross Margin	378,032	34.6%	260,927	29.7%	280,949	37.1%	314,498	34.1%
Net Income before tax	161,680	14.8%	58,453	6.7%	106,877	14.1%	122,094	13.2%
Net Income after tax	128,272	11.8%	44,522	5.1%	85,429	11.3%	87,486	9.5%
ROE	14.10%		4.76%		9.32%		10.20%	
EPS (NT\$/after tax)	\$4.75		\$1.57		\$3.02		\$3.33	

2021Q3 累計營收 相較於2020Q3 同期成長73%





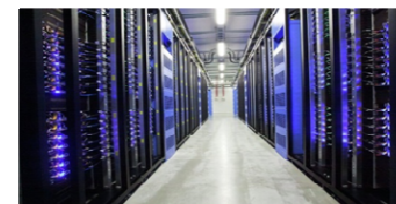
台灣半導體封裝製程設備產業



人工智慧(AI)



雲端科技



高速運算



手持裝置



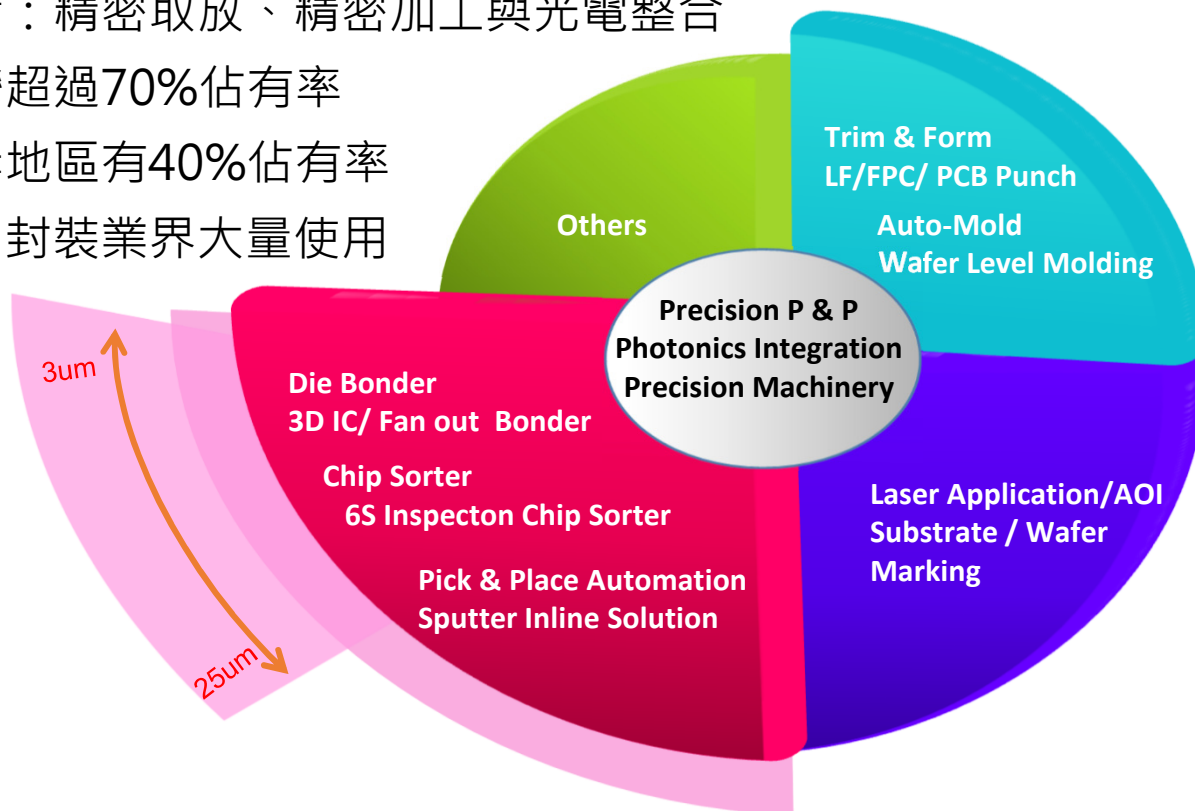
車用電子

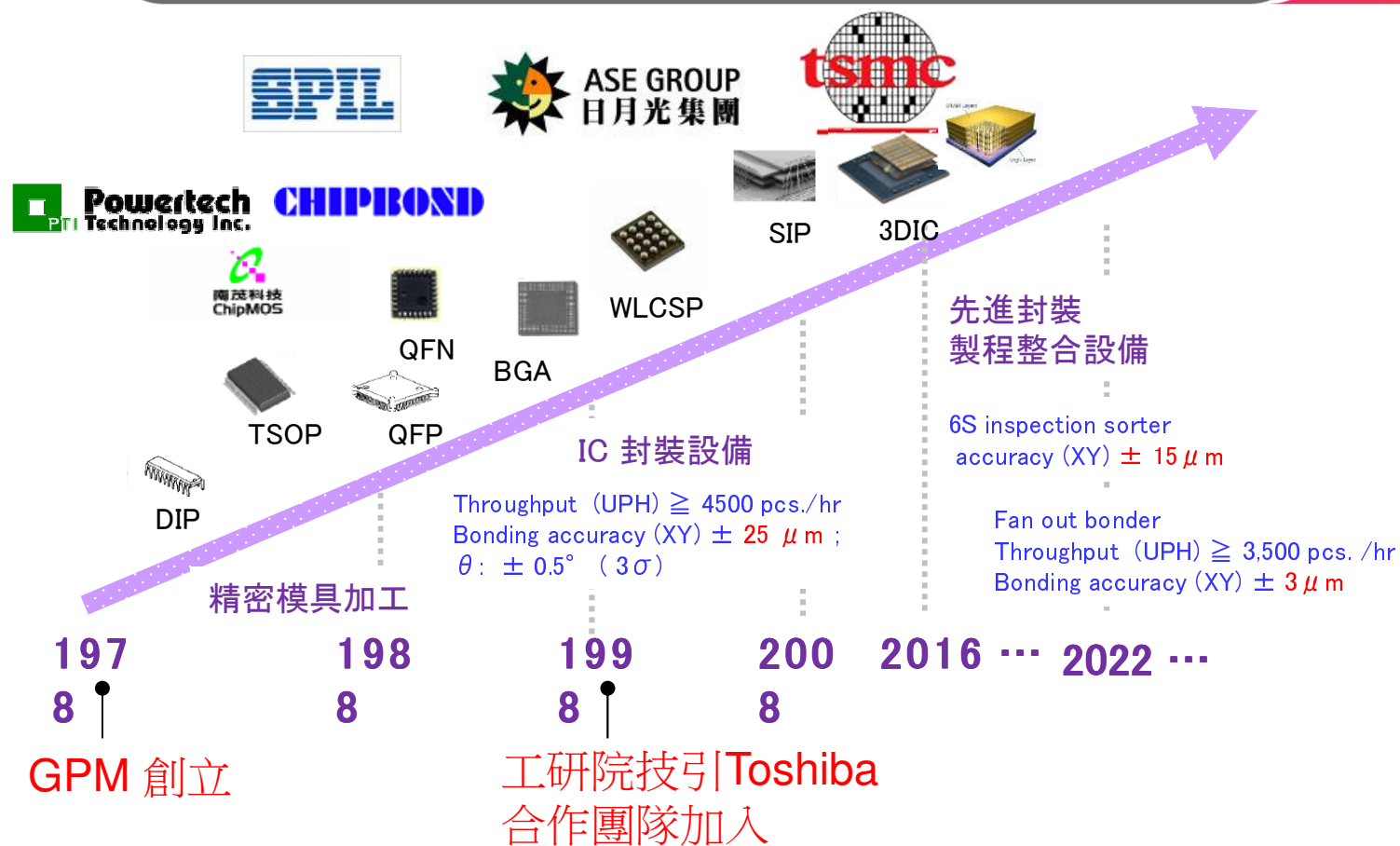


物聯網

IC Market
Advanced Packaging

- 關鍵核心技術包括：精密取放、精密加工與光電整合
- 晶粒挑揀機在台灣超過70%佔有率
- 沖切成型機在兩岸地區有40%佔有率
- 雷射刻印機為國內封裝業界大量使用





老品牌

- 半導體一線大廠客戶肯定

在地服務

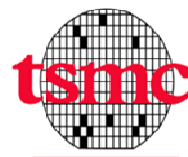
- 提供客戶快速有效方案
- 掌握市場脈動與需求

技術研發

- 協助客戶開發
- 新型封裝製程設備

日月光
最佳供應商獎智慧機械
金質獎

- 成為世界級/區域性領導企業為目標
- 專注特定領域及市場
- 價值導向為訴求



掌握5G、SiP、Flash memory與先進封裝的投資, 佈局主力產品





GMM

市場趨勢 & 產品發展

加工

沖切成型機
自動封膠機

取放

晶粒挑揀機
黏晶機

整合

雷射刻印機
光學檢測機

1. 一線大廠合作，提供主製程設備
2. 精密取放核心，擴展延伸應用
3. 以台灣主軸營運產品，持續推展至大陸市場
4. 整合雷射與AOI、AI技術，提高核心產品價值
5. 精密控制技術加持，切入電測市場
6. 結合G2C，推展至PCB與面板廠應用市場

祁昌電測 - CCD自動對位電測機

16



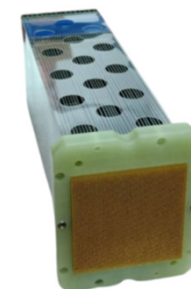
U800
FPC/HDI/CCT
單手臂全自動電測機



U820
IC載板/軟硬結合板
雙手臂全自動電測機



U20ST/EX
HDI
轉盤電測機



8192 (4096點)
2+4W電測系統

市場規模(年)：數量 200台，市值 1億美元以上

用於IC載板、HDI、車用、5G，一切電子設備之PCB最終電測

一線大廠
認證中

向日本大廠R公司致敬

高階封裝

先進封裝

擴大應用







G2C+

係由夥伴公司共組之團隊聯盟

Q & A





11/23^(二)
2021

G2C+

Thank You
聯盟法人說明會